

기술분석보고서 IT

이엘씨(041520)



작성기관 서울평가정보(주) 작성자 윤상우 책임

[YouTube 요약 영상 보러가기](#)

- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미게재 상태일 수 있습니다.
- 텔레그램에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의로는 작성기관(TEL.02-3449-1808)로 연락하여 주시기 바랍니다.

- ▶ 요약
- ▶ 기업현황
- ▶ 시장동향
- ▶ 기술분석
- ▶ 재무분석
- ▶ 주요 변동사항 및 전망

이엘씨(041520)

반도체 후공정 기술 전환기를 맞은 정밀 제어기업의 성장 전략

기업정보(2025.11.17 기준)

대표자	김성익
설립일자	1984년 4월 23일
상장일자	2003년 7월 4일
기업규모	중소기업
업종분류	물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업 유량계, 스피너
주요제품	모터, 반도체 PKG용 스트립 그래인더

시세정보(2025.11.17 기준)

현재가(원)	6,400
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	780
발행주식수	12,188,730
52주 최고가(원)	10,070
52주 최저가(원)	4,495
외국인지분율	2.35%
주요주주	김중헌 외 3인

■ 사업구조 전환과 핵심 경쟁력의 재정비

이엘씨(이하 '동사')는 1984년 설립되어, 1998년부터 시작한 디스플레이 BLU 사업에 대해 2024년 3월 영업중단을 결의하였고, 이후 반도체 제어 계측기기 및 장비 분야로 사업구조를 전환하였다. 반도체 세정장비용 제어 계측기기 제조 사업을 영위하던 (주)에스앤씨와의 합병을 통해 기술자산과 인증, 생산설비가 통합되며 연구개발 역량이 한층 강화되었다. 이를 통해 유량제어·약액제어와 정밀연삭 등 핵심 기술이 단일 체계로 집약되었고, 초음파 유량계, 스트립 그래인더 장비 등 반도체 세정·패키징 공정에 특화된 고부가가치 제품군 중심의 사업 포트폴리오를 구축하고 있다.

■ 반도체 패키징 시장 진입과 성장 모멘텀 확보

글로벌 반도체 후공정 산업은 인공지능, 고성능 컴퓨팅, 2.5D·3D 패키징 기술 확산으로 구조적 성장기에 진입하였다. 동사는 웨이퍼 및 패널 레벨 패키징(WLP·PLP), Strip Base의 Mold Grinding 등 첨단 패키징 공정에 대응하는 장비 및 제어 솔루션 개발과 국산화를 통해 신규 수주 기반을 확대하고 있다. 기존 에폭시 몰딩 컴파운드(EMC) 단일소재 중심의 연삭공정에서 복합소재 가공 기술로 확장하면서, 산업 변화에 선제적으로 대응하고 있다. 이는 향후 국내외 고객 레퍼런스 확대 및 안정적 외형 회복의 핵심 동력으로 작용할 전망이다.

■ 기술 내재화와 지속가능한 성장 기반 구축

동사는 세정장비의 제어계측기기 분야에서 실시간 공정 모니터링, 친환경 약액제어와 패키징 장비에서 복합소재 연삭기술 등 차세대 기술을 중심으로 연구개발 역량을 강화하고 있다. 연구개발비 비중은 매출의 약 10% 내외를 유지하며, 제품 성능 고도화와 장비 간 인터페이스 표준화를 추진 중이다. 또한 인증기반의 품질경영시스템 개선을 통해 글로벌 신뢰도를 높이고 있으며, 내수와 수출시장을 아우르는 이원적 성장 구조를 구축하고 있다.

요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2022	1,375.7	-26.2	-95.0	-6.9	-57.8	-4.2	-2.8	-2.4	17.2	-475	16,304	N/A	0.3
2023	161.2	-88.3	-73.1	-45.3	-78.4	-48.7	-4.1	-3.6	11.6	-644	15,744	N/A	0.5
2024	292.3	81.4	-46.8	-16.0	-2.7	-0.9	-0.2	-0.1	5.5	-22	15,368	N/A	0.3

기업경쟁력

기술 내재화와 통합 생산체계 확보	<ul style="list-style-type: none"> 제어계측기기 기업과 합병 이후 연구개발·인증·생산 일원화로 내부 효율성 향상 유량제어·약액제어, 패키징 복합소재 정밀연삭 기술을 기반으로 반도체 성능에 기여 제품 생산의 자체 설계·제작·검증까지 전 과정 내재화
반도체 특화 기술 기반의 진입장벽	<ul style="list-style-type: none"> 공압식 초음파 유량계 국산화 성공 세정공정 내 검증 필수 부품으로 고객 신뢰도 확보 기술 신뢰성으로 후발주자 진입장벽 형성

핵심 기술 및 적용제품

센서 · 밸브 융합형 계측 제품군	<ul style="list-style-type: none"> LFC, 초음파 유량계 등 반도체 약액공정용 계측장비 고정밀 센서모듈과 전자식 밸브 통합으로 성능 향상 		
복합소재 대응 정밀 연삭 기술	<ul style="list-style-type: none"> EMC·Die-Cu Post 등 복합소재의 단일공정 가공 가능 WLP·PLP 등 첨단 패키징 공정에서 열 방출 효율 극대화 		
		동사의 초음파 유량계 제품	동사의 그라인더 장비

시장경쟁력

후공정 산업 성장과 동반 확장성	<ul style="list-style-type: none"> 글로벌 후공정 장비시장 연평균 성장률 8.7% 이상 PLP·WLP 대응 장비로 산업 성장세에 선제 진입
고부가가치 중심의 제품 포트폴리오 전환	<ul style="list-style-type: none"> LCD용 백라이트 유닛(BLU) 사업 철수, 반도체 장비·계측 중심 구조로 개편 고수익 장비 비중 확대에 따른 수익성 개선
내수 안정성과 수출 성장의 균형	<ul style="list-style-type: none"> 세정장비 중심의 내수 안정적 수요 확보 패키징 장비 수출 확대로 매출 다변화 추진

ESG(Environmental, Social and Governance) 활동 현황

E 환경경영	<ul style="list-style-type: none"> ◎ CE 인증을 통한 국제환경기준 준수, 비접촉 초음파 유량계 및 저전력 제어장비 개발로 에너지 효율 향상 ◎ 세정공정용 약액 절감 및 재활용 시스템을 적용해 화학물질 사용 최소화 ◎ 공정 자동화 및 정밀화로 불량률 및 폐기물 발생 저감 추진
S 사회책임경영	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 인재양성에 대한 지속적 투자 및 직무 전문성 향상 교육 실시 ◎ 공정한 채용 및 근로환경 조성으로 '일하고 싶은 기업' 문화 확립 ◎ 지역사회 공헌활동 및 협력사 상생 프로그램 운영 ◎ 고용창출 및 새로운 노사문화 정착을 선도하는 중견기업 지향
G 기업지배구조	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 공정하고 투명한 기업문화를 기반으로 한 윤리규정 제정 및 실천 ◎ 이해충돌 방지, 부당이득 수수금지 등 임직원 행동기준 명문화 ◎ 경영진의 책임경영 및 투명한 정보공개를 통한 신뢰 확보

I. 기업 현황

디스플레이 기업에서 반도체 제어계측·장비 전문기업으로 전환

동사는 과거 LCD 디스플레이용 백라이트 유닛(BLU)을 주력으로 성장하였으나 산업 구조 변화에 대응해 반도체 장비 및 제어계측기기 전문기업으로 사업영역을 전환하였다. 2024년을 기점으로 BLU 사업을 완전히 종료하고, 반도체 공정용 유량계·스피너·스트립그라인더 등 정밀제어기술을 기반으로 새로운 매출원을 확보하였다. 국내외 반도체 제조업체를 주요 고객으로 두고 있으며, 기존 디스플레이 제조 인프라를 활용해 생산 효율성과 기술 내재화를 강화하고 있다. 현재는 구조개선을 마치고 사업 안정화 단계에 진입하였다.

■ 기업 개요

동사는 1984년 4월 23일에 설립되어, 담배필터 제조를 주력으로 하였으나, 1998년 6월 LCD 백라이트 유닛(BLU) 사업에 진출하였고 2000년 7월 회사 분할을 통해 (주)이라이콤으로 사명을 변경, 필터 사업을 신설 법인 (주)신평으로 이관하였다. 2003년 7월 4일 코스닥 시장에 상장하였으며, 이후 백라이트 유닛(BLU) 제조를 중심으로 한 디스플레이 부품 전문기업으로 성장하였다. 그러나 글로벌 디스플레이 산업이 LCD에서 OLED로 급속히 전환되면서 동사는 기존 주력사업의 성장 한계를 인식하고, 2020년 이후 반도체 공정용 장비 및 제어계측기기 분야로 사업구조를 전환하였다. 2024년에는 BLU 부문 사업을 전면 종료하고 (주)이엘씨로 사명을 변경하였으며, 반도체용 유량계, 스피너, 스트립 그라인더(Strip Grinder) 등 고정밀 제어장비를 주력 제품으로 하는 기술집약형 기업으로 재편되었다.

현재 본사는 충청남도 아산시 음봉면 스마트산단1로 20에 위치하며, 반도체 산업 내 수요 확대에 맞춰 관련 부품 및 계측장비의 국산화를 적극 추진 중이다. 영업구조는 국내 반도체 장비업체 및 소재기업을 대상으로 한 직접 납품 중심으로 구성되어 있으며, 일부는 해외 반도체 제조사에도 공급되고 있다.

주요 종속기업으로는 반도체 제조용 장비 생산을 담당하는 서우테크놀로지(주)가 있으며, 2020년 인수되어 동사의 장비 사업 핵심축을 담당하고 있다. 또한 2024년 2월 1일에는 반도체 공정용 제어계측기기 전문기업 (주)에스앤씨를 흡수합병하여, 계측기기 및 유량제어 분야 기술을 내재화함으로써 반도체 장비의 핵심 구성요소인 유량계(Liquid Flow Controller, LFC) 및 고정밀 스피너 제품군을 직접 설계·생산할 수 있는 기반을 확보하였다. 이와 같은 사업재편을 통해 동사는 디스플레이 중심의 단일 사업구조에서 벗어나 반도체 장비와 계측기기라는 이중 포트폴리오를 구축하였다.

[표 1] 동사의 주요 연혁

1984.04	(주)신평물산 설립, 담배필터 제조 및 납품
1998.06	LCD 백라이트 유닛 사업 진출
2000.07	(주)이라이콤으로 사명 변경, (주)신평으로 필터 사업 이관
2003.07	코스닥 시장 상장
2009.09	기업부설연구소 설립
2020.06	서우테크놀로지(주) 인수, 국내외 반도체 제조업체에 패키징 공정 설비 공급
2023.07	(주)에스앤씨 지분 100% 인수
2024.03	(주)에스앤씨 흡수합병, BLU 사업 종료

자료: 동사 홈페이지, 서울평가정보(주) 재구성

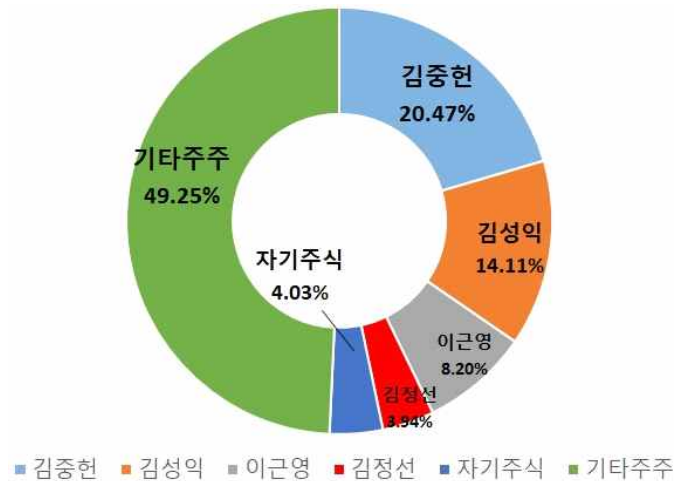
■ 주주 현황

2025년 8월 기준, 동사의 최대주주는 동사 회장직을 역임하고 있는 김중현으로, 전체 발행주식(12,188,730주) 중 2,494,541주의 주식을 보유하고 있으며, 이는 전체 지분의 20.47%에 해당한다. 다음으로 김성익 대표이사가 1,720,000주(14.11%), 특수관계자 이근영이 999,453주(8.20%) 김정선이 480,000주(3.94%)를 각각 보유하고 있다. 이 외에 자기주식이 490,609주(4.03%)이며 기타주주가 6,004,127주(49.25%)를 보유하고 있다. 이에 따라 최대주주 및 특수관계자의 보유주식 합계는 약 46.72%로, 경영진 중심의 안정적인 지배구조를 유지하고 있다.

[표 2] 동사의 주요 주주 현황

(단위 : 주, %)

주주명	소유주식수(주) ^{주1)}	지분율(%)	관계
김중현	2,494,541	20.47	최대주주
김성익	1,720,000	14.11	대표이사
이근영	999,453	8.20	특수관계자
김정선	480,000	3.94	특수관계자
자기주식	490,609	4.03	
기타주주	6,004,127	49.25	
합계	12,188,730	100.00	



주1) 보통주식

자료: 동사 반기보고서(2025.08), 서울평가정보(주) 재구성

■ 사업 영역

동사의 사업 영역은 제어계측기기 부문과 반도체 장비 부문의 두 축으로 구성되어 있다. 제어계측기기 부문은 반도체 제조공정 중 세정·식각·도금 공정 등에서 사용되는 유량제어장치, 스피너, 약액 공급시스템 등으로 구성된다. 해당 제품들은 초정밀 화학약품의 유량과 압력을 정밀하게 제어하는 핵심 장비로, 미세공정 안정성과 생산 효율을 높이는 역할을 한다. 동사는 2024년 (주)에스앤씨를 흡수합병하며 관련 기술과 제조라인을 통합하였으며, 이를 통해 반도체 공정용 계측장비의 자체 설계 및 생산 역량을 강화하였다. 현재 주요 고객사는 국내 반도체 세정설비 제조업체와 소재기업으로, 향후 글로벌 반도체 장비사로의 공급 확대를 추진하고 있다.

반도체 장비 부문은 웨이퍼 레벨 패키징(WLP)과 패널 레벨 패키징(PLP) 공정에 적용되는 스트립 그라인더(Strip Grinder) 및 PLP 그라인더(PLP Grinder) 등의 정밀 가공장비를 중심으로 구성되어 있다. 이 장비들은 서로 다른 종류의 소재를 결합하여 반도체의 성능을 향상시키는 첨단 패키징(Advanced Packaging) 공정에서 반도체 패키지의 몰딩층을 일정 두께로 연마하여, 특히 열 방출을 최적화하는 그라인딩 기술의 적용으로 제품의 신뢰성과 열특성을 개선하는 역할을 수행한다. 동사는 2020년 서우테크놀로지(주)를 인수하여 관련 기술을 내재화하였으며, 이를 기반으로 고성능 패키징 공정용 장비 개발을 지속하고 있다. 특히 최근에는 RF 전공정 모듈, 메모리, 파워 모듈, AI 반도체용 고정밀 연삭 장비로 제품군을 확장하면서 매출 밀바탕을 넓혀가고 있다.

동사의 이러한 두 사업부문은 상호보완적 관계를 형성하고 있다. 제어계측기기 부문은 세정공정 효율과 수율 향상을 위한 정밀 제어 솔루션을 제공하고, 반도체 장비 부문은 실제 제조 라인(패키징 공정)에 적용되는 핵심 장비를 공급함으로써 기술적·산업적 연계를 강화한다. 이러한 구조를 통해 동사는 반도체 제조 후공정 전반을 아우르는 포트폴리오를 구축하고 있으며, 향후 소재·부품·장비 융합형 반도체 기술 기업으로의 성장을 목표로 하고 있다.

■ 판매경로 및 수주 현황

동사의 제품은 국내 반도체 장비업체와 소재기업, 그리고 일부 해외 반도체 제조사를 주요 고객으로 하고 있다. 제어계측기기 부문 제품은 주로 반도체 세정 공정용 설비를 생산하는 장비제조사에 직접 납품되는 형태이며, 영업 과정에서 기술협업과 사양개발 단계가 함께 진행되는 맞춤형 B2B 구조를 갖추고 있다. 특히 LFC 및 스피너 제품은 각종 사양별로 라인업 되어 있으며, 이를 통해 고객사의 설비 신뢰성과 생산 수율을 높이는 데 기여하고 있다. 반도체 장비 부문은 수주 기반 영업방식이 주를 이루며, 고객의 공정기술 변화에 따라 장비 설계 및 납품 일정이 조정되는 프로젝트형 매출 구조를 가진다. 주요 제품인 스트립 그라인더는 반도체 패키지의 몰딩층을 연삭하여 일정한 두께로 맞추는 장비로, 주문형 생산방식으로 납품된다.

최근 동사는 제어계측기기 부문에서 고객 요구에 부합하는 정밀 약액 계측 및 제어기술 고도화를 중심으로 신규 제품 개발을 지속하고 있다. 센서 기술과 기구 설계 경험을 결합하여 정밀도를 높인 계측 알고리즘을 적용하고 있으며, 고부가가치 제품군 확장을 통해 반도체 세정 및 식각 공정용 제어장비 시장 내 경쟁력을 강화하고 있다. 한편, 반도체 장비 부문에서는 패키징 미세화 추세에 따른 공정 정밀도 향상 요구에 적극적으로 대응하며, 신규 장비 공급을 위한 기술개발 역량을 집중하고 있다.

판매경로는 대부분 직거래 방식으로 이루어지며, 국내에서는 수도권 및 충청권에 위치한 주요 반도체 장비기업과 장기공급계약을 체결하여 안정적인 납품체계를 유지하고 있다. 해외의 경우 중국 지역을 중심으로 반도체 세정설비 제조사와의 공급 협력이 이루어지고 있으며, 동사는 이를 기반으로 점진적인 수출 비중 확대를 추진 중이다. 2024년 기준 동사의 총매출은 292.3억 원으로 전년 대비 81.4% 증가하였으며, BLU 사업 철수 이후 반도체 장비와 제어계측기기 두 핵심 부문이 성장 중이다. 전체 매출 중 수출은 174.6억 원(59.7%), 내수는 117.7억 원(40.3%)으로, 수출 비중이 전년보다 상승하며 글로벌 시장 진출이 본격화된 모습을 보였다.

[표 3] 동사의 사업부문 별 수출 및 내수 실적

(단위 : 억 원)

사업부문	판매경로	판매 실적						증감률 (2024년)
		2022년		2023년		2024년		
		매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	
제어계측기기 (유량계, 스피너 및 감속기 등)	수출	-	-	2.4	1.5%	55.2	18.9%	2,180.6%
	내수	-	-	42.7	26.5%	111.3	38.1%	160.9%
반도체 장비	수출	311.8	22.7%	99.6	61.8%	119.4	40.8%	19.9%
	내수	28.5	2.1%	16.5	10.2%	6.4	2.2%	-61.1%
BLU (휴대폰, 태블릿, 소형가전제품 용)	수출	1,025.0	74.5%	-	-	-	-	-
	내수	10.4	0.7%	-	-	-	-	-
합계	수출	1,336.9	97.2%	102.0	63.3%	174.6	59.7%	71.1%
	내수	38.8	2.8%	59.2	36.7%	117.7	40.3%	99.0%
	합계	1,375.7	100.0%	161.2	100.0%	292.3	100.0%	81.4%

자료: 동사 사업보고서(2025.03), 서울평가정보(주) 재구성

II. 시장 동향

AI 반도체 확산과 첨단 패키징 기술 고도화로 후공정 장비 시장의 성장세

글로벌 반도체 후공정 장비 시장은 AI 반도체와 고대역폭 메모리(HBM)의 수요 확대에 따라 구조적 성장 국면에 진입하고 있다. 첨단 패키징과 미세공정 대응 세정공정의 중요성이 부각되면서 후공정 설비에 대한 반도체 제조사의 투자가 꾸준히 확대되고 있으며, 장비의 정밀제어·계측 기술 수요도 동반 증가하고 있다. 이러한 흐름 속에서 국내 반도체 장비기업들은 장비 국산화와 기술 내재화를 가속화하고 있으며, 동사 역시 제어계측기기와 패키징 장비 분야를 중심으로 시장 확대에 참여하고 있다.

■ 시장의 특성

반도체 후공정 장비 시장은 웨이퍼 가공이 완료된 반도체 칩을 패키징·세정·테스트하는 과정에서 사용되는 다양한 장비로 구성된다. 전공정(Front-End)이 회로 형성 중심이라면, 후공정(Back-End)은 제품의 신뢰성과 성능을 결정하는 완성단계로, 공정 정밀도와 수율 향상이 핵심 경쟁요소로 작용한다. 특히 최근 AI 반도체와 고성능 연산용 칩의 수요가 확대되면서, 고집적·고열효율을 위한 첨단 패키징 기술의 중요성이 부각되고 있다. 이에 따라 WLP, PLP, 고대역폭 메모리(HBM) 등의 신공정이 확산되며 관련 장비 수요가 급증하고 있다.

후공정 장비 시장의 성장성은 첨단 패키징 기술과 미세공정 기술의 발전 속도에 밀접하게 연동되어 있다. 글로벌 시장조사기관들은 특히 AI 반도체와 서버용 고성능 DRAM, CMOS 이미지센서(CIS) 등의 수요 증가가 시장 확대의 주요 요인으로 작용할 것으로 전망하고 있다. 이러한 추세 속에서 후공정 장비의 자동화·정밀화 기술이 산업의 핵심 경쟁력으로 부상하고 있으며, 정밀 제어·계측기기 시장 또한 함께 성장하고 있다.

경쟁구조는 글로벌 대형 장비사와 국내 중견기업 간의 기술격차가 점차 축소되는 방향으로 전개되고 있다. 일본과 미국의 주요 장비업체들이 여전히 높은 시장 점유율을 유지하고 있으나, 국내 기업들은 첨단 패키징 장비 국산화를 추진하며 기술 내재화 속도를 높이고 있다. 또한 반도체 제조사와 장비기업 간의 공동개발과 기술협력 사례가 증가하면서, 장비 설계 단계부터 고객 맞춤형 대응체계가 표준화되고 있다. 이 과정에서 중견기업의 기술 경쟁력 확보와 시장 진입 기회가 확대되고 있다.

정책 및 경기변동 측면에서 후공정 장비 산업은 글로벌 반도체 투자 사이클에 직접적인 영향을 받는다. 주요 메모리 업체의 투자 조정이나 설비투자(CAPEX) 변동이 장비 수주에 영향을 미치지만, AI 반도체 및 첨단 패키징 수요 확대는 중장기적으로 안정적인 성장 흐름을 유지하게 하는 요인으로 작용하고 있다. 또한 각국의 반도체 산업 육성정책과 공급망 재편 기조가 장비 국산화를 촉진하며, 기술 의존도 완화를 위한 내재화 투자가 꾸준히 이어지고 있다. 이러한 환경은 후공정 장비 및 계측기기 전문기업인 동사에게 중장기적인 성장 기회로 작용하고 있다.

■ 핵심 트렌드 및 시사점

글로벌 반도체 후공정 장비 시장은 AI 반도체 및 고성능 패키징 수요의 급증으로 장비 고도화와 투자 확대가 동시에 진행되고 있다. 특히 WLP·PLP 등 첨단 패키징 공정이 AI 칩 및 HBM 생산의 핵심으로 부상하면서, 정밀 가공·세정·계측 장비에 대한 수요가 급격히 증가하고 있다. Mordor Intelligence 조사에 따르면 글로벌 후공정 장비 시장은 2025년 204.8억 달러에서 2030년 311.5억 달러로 성장할 전망이며, 연평균 성장률(CAGR)은 약 8.7%로 예상된다. 이러한 성장세는 지역별 생산기지 분산과 공급망 재편 정책의 영향을

받아, 우리나라와 대만, 일본을 중심으로 패키징 및 세정 공정 장비의 국산화 투자가 활발하게 진행되는 것으로 나타난다. 동사는 이러한 산업 흐름에 맞춰 제어계측기기 부문에서는 세정장비 핵심 부품의 국산화를 통해 기술 자립을 추구하고, 반도체 장비 부문에서는 WLP·PLP 공정 대응 장비의 수출 비중을 확대하며 글로벌 공급망 진입을 가속화하고 있다.

또한 공정 미세화와 정밀도 요구가 높아지면서 자동화·계측 기술의 중요성이 한층 강조되고 있다. 이에 따라 동사의 정밀 유량제어 기술 및 패키징 연삭장비는 후공정 공정의 품질 향상과 생산효율 제고에 기여할 수 있는 핵심 솔루션으로 평가된다. 즉, 글로벌 후공정 장비 시장의 구조적 성장 흐름은 동사의 기술 방향성과 직접적으로 연결되어 있으며, 이는 중장기 사업 확장 및 수익성 개선의 핵심 기회로 작용할 것으로 보인다.

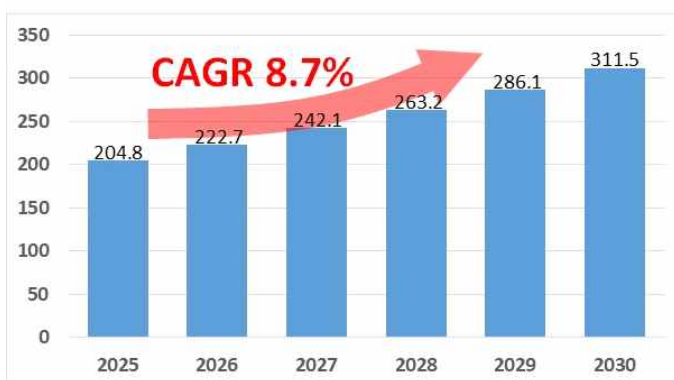
후공정 장비 산업은 고도의 기술 집약적 구조를 지니며, 소수의 글로벌 대형 장비사와 국내 중견 장비기업이 경쟁하는 형태로 구성되어 있다. 해외 시장에서는 미국·일본·대만의 장비업체들이 첨단 패키징 및 계측장비 분야에서 높은 기술 장벽을 유지하고 있으며, 국내 시장에서는 반도체 제조사 협력 네트워크를 중심으로 한 전문 장비기업들이 국산화와 기술 내재화를 추진하고 있다.

동사가 속한 산업군은 부품의 국산화율이 낮고, 고객 맞춤형 설계와 품질 인증이 중요한 특성을 가진다. 이에 따라 동사의 경쟁우위는 정밀 제어기술, 장비 커스터마이징 대응력, 그리고 생산 효율성 확보 능력에 기반하고 있다. 동사의 패키징 장비 부문에서는 WLP·PLP 공정 대응 장비를 중심으로 국내외 고객사 맞춤형 설계를 강화하고 있으며, 기존 대형 장비업체가 주도하던 시장 내에서 중형 장비기업으로서 기술 대응 속도와 서비스 품질을 무기로 점진적인 시장점유율 확대를 시도하고 있다. 또한 제품 개발 단계부터 고객사와의 협력강화를 통해 수요 변화에 대응하는 기술 민첩성을 확보하고 있다는 점에서, 동사는 경쟁사 대비 높은 기술 적응력을 보유하고 있다.

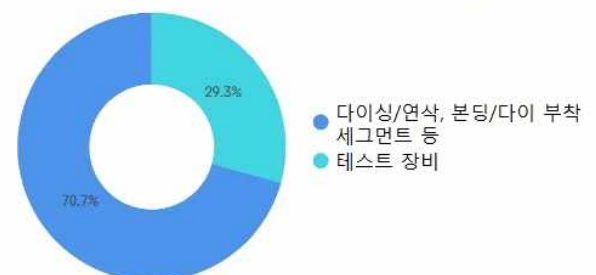
종합적으로 볼 때, 동사는 글로벌 시장에서 기술적 차별화와 국내 시장 내 신뢰성 확보를 통해 점진적인 입지를 넓혀가고 있으며, 향후 반도체 공정 자동화·고정밀화 흐름에 맞춰 시장 지위를 강화할 가능성이 높다고 판단된다.

[그림 1] 글로벌 반도체 후공정 장비 시장 규모

(단위 : 억 달러, %)



반도체 후공정 장비 시장
2024년 기준, 장비별 시장 점유율



Source: Mordor Intelligence



자료: Semiconductor Back-End Equipment Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2025 - 2030), Mordor Intelligence, 서울평가정보(주) 재구성

III. 기술분석

정밀 제어기술과 장비 내재화를 통한 반도체 후공정 기술경쟁력 강화

동사는 반도체 후공정 분야에서 정밀 제어·계측 기술을 기반으로 핵심 장비 경쟁력을 확보하고 있다. 제어계측기기 부문에서는 반도체 세정공정에 필요한 유량계, 스피너, 센서 기술을 내재화하여 고정밀 약액 제어와 공정 안정성을 구현하고 있다. 반도체 장비 부문에서는 웨이퍼 및 패널 레벨 패키징 공정용 스트립 그라인더와 연삭장비 개발을 통해 첨단 패키징 시장 진입 기반을 마련하였다. 또한 연구개발조직을 일원화하고 고객 맞춤형 장비 개발체계를 구축함으로써, 기술개발에서 생산까지의 수직통합 구조를 강화하고 있다.

■ 핵심 기술 개요 및 적용 제품

동사는 반도체 후공정 장비 산업에서 정밀 제어 및 계측 기술을 기반으로 한 기술 내재화를 추진하고 있다. 제어계측기기 부문에서는 세정 및 식각 공정에서 사용되는 약액의 유량과 압력을 안정적으로 제어하기 위한 유량계와 센서류를 개발·양산하고 있다. 해당 기술은 공정 내 약액의 균일한 분사와 흐름 제어를 가능하게 하여 세정 효율과 공정 재현성을 향상시키며, 반도체 제조 장비의 정밀도를 높이는 핵심 구성요소로 활용된다. 또한, 고부식성 약액 환경에서도 안정적인 동작을 유지할 수 있도록 내식성 소재와 고응답 제어 알고리즘을 적용하였으며, 이를 통해 기존 수입 부품의 대체와 국산화 확대를 동시에 추진하고 있다.

반도체 장비 부문에서는 첨단 패키징 공정에서 사용되는 그라인더(연삭) 장비를 중심으로 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 장비는 패키징 단계에서 반도체의 열 방출 성능을 개선하고 구조적 안정성을 확보하기 위해 적용되며, 서로 다른 소재를 복합적으로 가공할 수 있는 정밀 연삭기술을 기반으로 한다. 기존의 에폭시 몰드 컴파운드(EMC) 단일 소재 가공에서 벗어나 EMC와 반도체 다이(Die), 솔더볼(Solder Ball), 구리 포스트(Cu Post), 실리카, 알루미늄 등 복합소재를 동시에 연삭하는 공정이 확대되고 있으며, 동사는 이에 대응하기 위한 스핀 제어 및 압력 분산 기술, 소재별 가공 알고리즘을 확보하였다. 이러한 기술은 발열 제어가 중요한 AI 반도체와 고성능 메모리 패키징 공정에서 생산 효율과 품질 안정성을 높이는 역할을 수행하고 있다.

동사는 제어계측기기와 패키징 장비를 축으로 반도체 후공정의 정밀화·자동화 흐름에 대응하고 있으며, 기술 내재화를 통해 공정 안정성과 신뢰성을 동시에 확보하고 있다. 세정공정용 제어기술과 패키징용 정밀 가공기술을 바탕으로, 국내 반도체 장비산업의 핵심 과제인 기술 국산화에 기여함과 동시에 글로벌 시장 진입을 위한 기술 경쟁력 기반을 구축하고 있다.

[그림 2] 동사의 핵심 기술 적용 제품

유량 제어기	스피너 및 감속기	그라인더 시스템
		

자료: 동사 제품 카탈로그 및 서우테크놀로지(주) 홈페이지, 서울평가정보(주) 재구성

■ 연구개발활동

동사는 반도체 후공정 장비 산업에서 기술 내재화와 공정 혁신을 핵심 목표로 삼고, 기술연구소를 중심으로 연구개발 활동을 수행하고 있다. 연구소는 2009년 9월에 설립되어 기계, 정밀제어, 계측기술 분야를 중심으로 한 전문 연구인력을 보유하고 있다. 연구소는 반도체 세정 및 식각 공정용 제어계측기와 패키징 장비의 기술개발을 주력으로 하며, 공정 데이터 기반의 정밀 제어 알고리즘과 고부식성 약액 환경에서도 안정적인 제어가 가능한 소재기술을 병행 개발 중이다. 최근에는 공정 자동화, 장비 간 통신, 온·습도 보정 시스템 등 고도화 기술을 통합한 플랫폼 연구로 범위를 확장하고 있다.

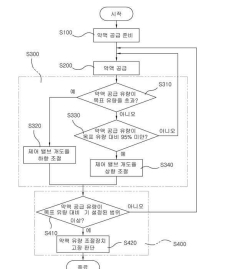
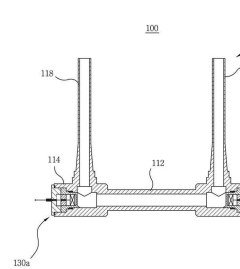

동사의 2024년 사업보고서에 따르면, 최근 3개년간 매출액 대비 연구개발비 비중이 2022년 1.53%에서 2023년 13.32%, 2024년 12.79%로 급격히 상승한 것으로 나타나 있으며, 이는 기술 중심 경영기조를 반영한다고 볼 수 있다. 제어계측기 부문에서는 초음파 기반 유량제어 및 밸브제어 기술의 정밀도 향상, 반도체 장비 부문에서는 첨단 패키징 대응용 정밀 그라인딩 공정 기술 확보에 연구 역량이 집중되고 있다. 동사는 연구소와 제조부문 간의 연계개발 체계를 강화하여 연구성과의 상용화를 가속화하고 있으며, 고객 맞춤형 장비개발을 위한 프로젝트도 병행 추진 중이다. 향후에는 복합소재 대응 정밀가공기술, 친환경 약액처리 기술을 차세대 연구과제로 설정하여, 후공정 장비산업의 기술 자립과 글로벌 경쟁력 강화를 동시에 달성할 계획이다.

■ 지식재산권 및 인증 현황

동사는 반도체 후공정 장비 및 제어계측기 분야에서 핵심 기술 경쟁력을 확보하기 위해 지속적인 연구개발과 지식재산권 관리체계를 운영하고 있다. 2025년 기준 동사가 보유한 지식재산권은 특허등록 총 8건, 디자인등록 7건으로, 주력 기술영역은 유량 제어 및 초음파 측정, 반도체 공정용 정밀 연삭장비 구조체 등이다. 특히 제어계측기 부문에서는 내부 유동해석 및 약액 제어 알고리즘 관련 연구성과가 국내 학술지에 게재되어, 기술의 신뢰성과 응용 가능성을 학문적으로도 검증받고 있다.

동사는 또한 (주)에스엔씨를 합병하며 해당기업의 ISO 9001 품질경영시스템 인증과 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 인증을 만족하는 역량을 확보해 품질경영 및 기술혁신 역량 강화를 하였다. 아울러 동사는 유럽규격(CE) 인증을 통해 해외 시장에서 요구되는 안전 및 품질 기준을 충족함으로써 글로벌 수준의 기술 신뢰성을 강화하고 있다.

[그림 3] 동사의 특허 활동 및 인증 현황

유량계 제품군 특허의 대표 도면	인증 현황
 	

자료: KIPRIS(2025.11), 동사 홈페이지, 서울평가정보(주) 재구성

■ PEST 분석

반도체 후공정 장비 산업은 글로벌 공급망 재편과 복합적인 거시환경 변화 속에서 구조적 전환기를 맞고 있다. 기술 집약적 산업 특성상 정책, 경제, 사회, 기술의 네 영역이 상호 영향을 미치며 산업 경쟁구조를 형성하고 있으며, 당사는 이에 대응하여 기술 내재화와 자동화 역량 강화를 중심으로 전략을 추진하고 있다.

정책적 요인으로는 국내외 반도체 산업 육성정책이 강화되면서 기술개발과 국산화에 대한 정책적 지원이 확대되고 있다. 정부는 반도체특별법 제정과 국가첨단전략산업 육성계획을 통해 세계 감면, 연구개발 투자세액 공제, 소재·부품·장비 자립화 프로젝트를 적극 추진 중이다. 이러한 정책환경은 후공정 장비 및 제어계측기기 기술의 내재화를 추진 중인 동사에게 긍정적 요인으로 작용하며, 특히 국산 장비 공급망 내 안정적 지위를 확보할 수 있는 기회가 되고 있다.

경제적 요인으로는, 2024년 이후 글로벌 반도체 경기의 회복과 함께 메모리 및 AI 반도체 중심의 설비투자가 점진적으로 재개되고 있다. 이에 따라 후공정 장비 수요가 확대되고 있으며, 고금리·고환율 기조 완화는 설비투자(CAPEX) 환경 개선으로 이어지고 있다. 반면 제조원가 상승과 경기 불확실성은 기술 내재화를 통한 비용절감 필요성을 높이고 있다. 당사는 이를 대응하기 위해 고정비 구조를 최소화하고, 핵심 부품의 국산화율을 높여 수익구조의 안정성을 확보하고 있다.

사회적 요인으로, 국내 반도체 산업은 전문기술인력 부족과 고령화, ESG 경영 강화 등 사회적 요구 변화에 직면해 있다. 특히 환경안전 관리와 에너지 절감형 설비의 도입이 산업 전반의 중요한 과제로 부상하고 있다. 당사는 이러한 사회적 흐름에 맞춰 친환경 약액제어 기술, 저소비전력 장비, 안전 자동화 시스템 등을 개발 중이며, 이를 통해 생산현장의 안전성과 지속가능성을 높이고 있다. 또한 산학협력 및 인력양성 프로그램을 통해 기술 전문인력의 확보 기반을 강화하고 있다.

기술적 요인으로는 첨단 패키징(Advanced Packaging)과 AI 반도체 수요 확대에 따라 웨이퍼 및 패널 레벨 패키징(WLP·PLP) 등 후공정 공정의 미세화와 복합화가 가속되고 있다. 이에 정밀 연삭장비, 고응답 제어기술, 실시간 공정 데이터 기반 계측시스템의 중요성이 커지고 있다. 당사는 이러한 기술 트렌드에 대응해 초음파·센서 기반 정밀 계측기술과 자동화 플랫폼을 결합한 신제품 개발을 추진하고 있으며, 연구개발 단계에서 확보한 알고리즘과 제어기술을 통해 기술경쟁력의 내재화를 강화하고 있다.

종합적으로 볼 때, 후공정 장비 산업은 정부정책의 지원, 경기 회복세, ESG 강화, 기술 패러다임 전환이 맞물린 성장기에 진입하고 있다. 당사는 이에 대응하여 기술자립, 공정효율화, 친환경화를 병행 추진함으로써, 외부 환경 변화를 기회 요인으로 전환하고 중장기적인 경쟁우위를 확보하고 있다.

[그림 4] PEST 분석



IV. 재무분석

기술 경쟁력 기반 매출 성장과 재무안정성 강화

동사는 2024년 매출 292.3억 원을 기록하며 전년(161.2억 원) 대비 81.4% 성장하였으며, 반도체 장비와 제어계측기기 중심의 사업 구조 전환을 통해 외형 확장에 성공했다. 영업이익은 2022년 이후 지속된 적자 흐름 속에서도 2024년 손실 폭을 축소하며 수익성 개선을 나타냈다. 당기순이익 역시 환율 효과 및 중단영업손실 축소로 손실 폭이 크게 감소하였다. 재무구조 측면에서는, 부채총계가 꾸준히 감소하며 2024년에는 부채비율이 5.5%로 낮아졌고, 현금및현금성자산을 확충하며 안정적인 유동성을 확보하고 있다.

■ 사업구조 전환 속에서도 외형 확장

동사의 최근 3년간 매출액은 2022년 1,375.7억 원, 2023년 161.2억 원, 2024년 292.3억 원으로 나타났다. 2022년에는 BLU 사업부문 매출이 반영되었으나, 2024년부터 해당 부문이 중단영업으로 분류되며 매출에 포함되지 않았다. 이후 사업 구조가 반도체 장비 및 제어계측기기 중심으로 재편되었음에도 불구하고, 2024년 매출은 전년 대비 81.4% 증가하며 외형 성장을 달성하였다.

부문별로는 제어계측기기 부문이 2023년 45.1억 원에서 2024년 166.5억 원으로 증가하며 성장을 주도했다. 초정밀 유량계, LFC, 스피너 등 핵심 부품군을 중심으로 주요 고객사 납품이 확대된 영향으로 판단된다. 반도체 장비 부문은 2022년 340.4억 원, 2023년 116.1억 원, 2024년 125.8억 원을 기록하며 안정적인 매출 흐름을 유지하였다. 고성능 반도체 패키징 공정에서 정밀 Grinding 기술의 적용이 확대되며 장비 및 부품 수요가 꾸준히 이어진 것으로 분석된다. 한편 BLU 부문은 2022년 1,035.4억 원의 매출을 기록하고, 중단영업으로 분류되어 이후 매출에는 반영되지 않았다.

또한 2024년 해외 수출액은 174.6억 원으로 전년(102.0억 원) 대비 71.1% 증가하며 외형 성장의 주요인이 되었으며 글로벌 반도체 고객사와의 공급망 확대가 본격화되며 수출액이 상승한 것으로 파악된다.

2025년 3분기 누적 매출액은 251.9억 원을 기록하며 전년 동기(190.6억 원) 대비 32.1% 증가하였다. 반도체 공정의 고성능화 트렌드에 따라 유량계 및 Grinding 장비 수요 확대가 예상되며, 동사의 기술 경쟁력과 고객 대응 역량을 바탕으로 매출 성장세가 지속될 전망이다.

■ 경상개발비로 인한 판관비 부담에도 수익성 개선 흐름

동사의 3년간 영업손실은 2022년 95.0억 원, 2023년 73.1억 원, 2024년 46.8억 원로 적자 폭이 점차 축소되었다. 판관비는 2022년 225.7억 원, 2023년 146.2억 원, 2024년 180.9억 원을 기록했으며, 판관비율은 각각 16.4%, 90.7%, 61.9%로 변동성이 있으나, 2024년의 경우 개선되었다. 특히 경상개발비는 2022년 20.6억 원, 2023년 21.5억 원, 2024년 37.4억 원으로 증가하며 R&D 중심의 비용 구조가 지속되었다. 무형자산상각비 역시 2024년 34.7억 원으로 큰 비중을 차지하였으며, 전년(31.4억 원) 대비 소폭 상승했다.

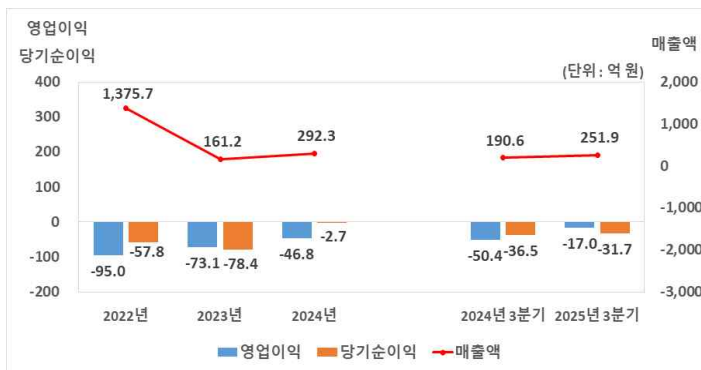
3개년 당기순손실은 2022년 57.8억 원, 2023년 78.4억 원, 2024년 2.7억 원을 기록하였으나, 2024년에는 손실 폭이 크게 축소되었다. 이는 환율 변동에 따른 외화환산이익이 2023년 4.4억 원에서 2024년 45.6억 원으로 증가하고, 중단영업손실이 128.2억 원에서 35.7억 원으로 감소한 영향이 컸다.

2025년 3분기 누적 실적은 영업손실 17.0억 원, 당기순손실 31.7억 원을 기록하였으며, 영업손실의 경우 매출 증가와 판관비율 개선(70.6%→55.7%)으로 전년 동기(50.4억 원 손실) 대비 66.2% 손실 규모가 축소되었다. 전반적으로, 당사는 손실 폭을 점진적으로 축소하며 수익성 개선의 흐름을 보이고 있다. R&D 중심의 비용 구조는 단기적으로 수익성 부담 요인이나, 중장기적으로 기술 경쟁력 확보와 매출 확대에 기여할 전망이다.

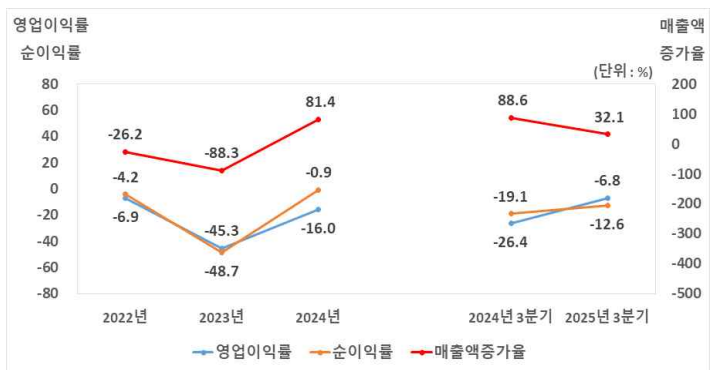
[그림 5] 동사 연간 요약 포괄손익계산서 분석

(단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)

매출액/영업이익/당기순이익 추이



증가율/이익률 추이



자료: 동사 사업보고서(2025.03), 분기보고서(2025.11) 서울평가정보(주) 재구성

■ 부채축소 통해 재무 안정성 향상

동사의 최근 3개년 연결재무제표를 살펴보면, 총자산은 2022년 2,328.7억 원, 2023년 2,056.2억 원, 2024년 1,896.6억 원으로 감소하였으며, 장기금융상품 축소(19.4억 원→소멸)와 매출채권및기타유동채권 감소(207.1억 원 → 98.0억 원)가 주요 요인이었다. 현금및현금성자산은 2022년 732.7억 원, 2023년 823.7억 원, 2024년 808.3억 원으로 2024년의 경우 소폭 감소하였으나, 이는 장기차입금 상환 및 배당금 지급의 영향이었다. 유동비율의 경우 2022년 558.2%, 2023년 927.4%, 2024년 1,846.5%로 상승하며, 안정적인 유동성 수준을 유지했다.

부채총계는 2022년 341.7억 원, 2023년 214.4억 원, 2024년 98.8억 원으로 꾸준히 감소했다. 장기차입금이 2023년 48.4억 원에서 2024년에는 소멸되었고, 단기매입채무 역시 68.8억 원에서 30.4억 원으로 줄어들며 부채 부담이 완화되었다. 이에 따라 부채비율은 2022년 17.2%, 2023년 11.6%, 2024년 5.5%로 하락하여 안정적인 재무구조를 유지하였다.

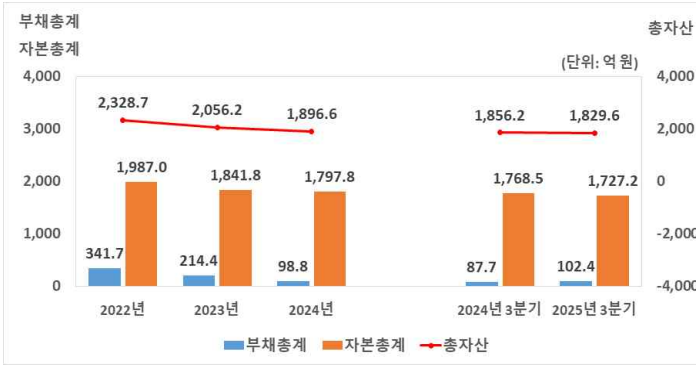
자본총계는 2023년 1,841.7억 원에서 2024년 1,797.8억 원으로 소폭 줄었으나, 이는 당기순손실 및 35.1억 원 규모의 배당금 지급에 기인하였다. 다만, 자기자본비율은 2022년 85.3%, 2023년 89.6%, 2024년 94.8%로 안정적인 수준을 보였다.

2025년 3분기 누적 기준 주요 재무지표는 유동비율 1,376.7%, 부채비율 5.9%, 자기자본비율 94.4%로, 양호한 재무 안정성을 유지하고 있다. 당사는 자산 효율화와 부채 축소를 통해 재무 건전성을 강화하고 있으며, 지속 가능한 재무 안정성을 유지할 것으로 전망된다.

[그림 6] 동사 연간 요약 재무상태표 분석

(단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)

자산/부채/자본 비교



자본 구조의 안정성



자료: 동사 사업보고서(2025.03), 분기보고서(2025.11) 서울평가정보(주) 재구성

[표 4] 동사 연간 요약 재무제표

(단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)

항목	2022년	2023년	2024년	2024년 3분기 누적	2025년 3분기 누적
매출액	1,375.7	161.2	292.3	190.6	251.9
매출액증가율(%)	-26.2	-88.3	81.4	88.6	32.1
영업이익	-95.0	-73.1	-46.8	-50.4	-17.0
영업이익률(%)	-6.9	-45.3	-16.0	-26.4	-6.8
순이익	-57.8	-78.4	-2.7	-36.5	-31.7
순이익률(%)	-4.2	-48.7	-0.9	-19.1	-12.6
부채총계	341.7	214.4	98.8	87.7	102.4
자본총계	1,987.0	1,841.8	1,797.8	1,768.5	1,727.2
총자산	2,328.7	2,056.2	1,896.6	1,856.2	1,829.6
유동비율(%)	558.2	927.4	1,846.5	1,725.3	1,376.7
부채비율(%)	17.2	11.6	5.5	5.0	5.9
자기자본비율(%)	85.3	89.6	94.8	95.3	94.4
영업현금흐름	-40.2	110.6	13.6	28.0	-10.2
투자현금흐름	22.0	123.4	7.0	16.4	-83.4
재무현금흐름	-114.1	-130.9	-91.9	-91.1	-39.9
기말현금	732.7	823.7	808.3	785.1	672.4

자료: 동사 사업보고서(2025.03), 분기보고서(2025.11) 서울평가정보(주) 재구성

■ 동사 실적 전망

동사는 2023년 매출 161.2억 원으로 전년(1,375.7억 원) 대비 88.3% 급감하였으나, 이는 BLU 부문 철수로 인한 일시적 영향이며, 사업구조 전환의 초기 단계로 해석된다. 2024년에는 반도체 장비 및 제어계측기기 부문에서 신규 수주가 확장되며 매출이 292.3억 원으로 전년(161.2억 원) 대비 81.4% 증가하였다. 2025년 3분기 실적 또한 251.9억 원으로 전년 동기(190.6억 원) 대비 32.2% 증가하여 회복세가 지속되고 있다. 다만 최근 개선 흐름에도 불구하고, 매출은 아직 2022년 수준에 크게 못 미치고 있어, 완전히 회복되기까지는 어느 정도 시간이 더 필요하다고 판단된다.

글로벌 반도체 산업은 통상 3~4년 주기의 경기 사이클을 보이며, 2023년을 저점으로 2024~2026년 회복 국면에 진입한 상태이다. WSTS(World Semiconductor Trade Statistics)와 SEMI 자료에 따르면, 2024년 반도체 시장은 전년 대비 13%, 2025년은 12% 성장할 것으로 전망되며, 특히 후공정 장비 시장은 연평균 15~18% 수준의 높은 성장세를 유지할 것으로 예측된다. 이러한 산업 흐름은 동사의 주력 사업인 반도체 장비 부문에 직접적인 긍정 요인으로 작용할 전망이다. 동사는 WLP·PLP 등 첨단 패키징 공정 확산에 대응한 고정밀 연삭장비를 주력 제품군으로 개발하고 있으며, 관련 수주가 본격화될 경우 매출의 점진적 확대가 가능하다.

제어계측기기 부문은 내수 중심의 안정적인 매출 기반을 유지하고 있으나, 기술개발 투자비가 지속되고 있어 단기적인 수익기여는 제한적이다. 다만 동사는 고부가가치 계측장비 및 약액제어 시스템 개발을 통해 장기적으로 안정적인 매출 포트폴리오를 구축하고 있다. 이러한 점을 종합적으로 고려할 때, 동사의 매출은 2025년 약 390.1억 원 수준으로 추정되며 점진적인 회복세를 이어갈 것으로 예상된다.

결론적으로 동사는 현재 반도체 산업 회복기의 초입에 있으며, 반도체 산업 경기 사이클과 맞물려 2026~2027년이 외형 성장의 가속 구간이 될 것으로 보인다. 이후 조정기에 진입하더라도, 내수형 제어계측기기 사업과 고부가 패키징 장비 매출의 균형이 확보된다면 외형 변동성은 완화될 것이다. 따라서 동사의 실질적 성장 국면은 2028년을 기점으로 산업 사이클의 확장 국면이 마무리되며 외형 복원과 체질개선이 동시에 완성되는 시점이 되어 중장기적인 매출실적 회복이 예상된다.

[그림 7] 동사 연간 실적 전망

(단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2025.03), 분기보고서(2025.11) 서울평가정보(주) 재구성

V. 주요 변동사항 및 향후 전망

사업구조 재편 완료, 기술 내재화와 패키징 시장 확장을 통한 도약 준비

동사는 2024년 (주)에스앤씨와의 합병을 기점으로 사업구조를 정비하고, 제어계측기기 및 반도체 장비 중심의 성장체제로 전환하였다. 기존 BLU 사업 철수로 일시적 외형 축소가 있었으나, 기술력 집중을 통해 핵심 분야의 경쟁력을 강화하고 있다. 특히 첨단 패키징 공정에 대응한 장비 및 계측 솔루션 개발이 본격화되며, 중기적으로는 기술 내재화와 글로벌 고객 확장을 동시에 추진할 계획이다.

■ BLU에서 반도체로, 사업구조 대전환 완료

동사는 기존 디스플레이용 BLU 사업을 종료하고, 반도체 산업 중심으로 사업구조를 재편하였다. (주)에스앤씨와의 합병을 통해 연구개발·인증·생산 인프라가 통합되면서 조직의 효율성이 높아졌고, 제어계측기기 및 반도체 장비 부문을 양대 축으로 한 단일 사업체계를 확립하였다. 이를 기반으로 반도체 제조공정의 정밀도와 생산성을 동시에 향상시킬 수 있는 솔루션 기업으로의 정체성을 강화하고 있다.

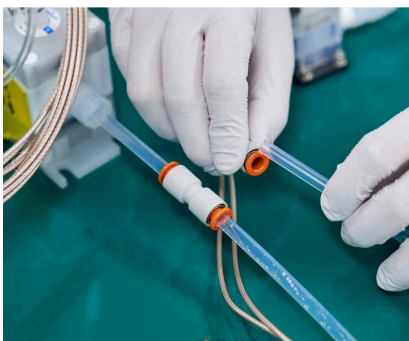
■ WLP-PLP 기술 주도권 확보, 신규장비 라인업 가속화

반도체 장비 부문에서는 PLP, WLP 등 첨단 패키징 공정에서 요구되는 정밀 연삭장비의 고도화를 추진 중이다. 최근에는 EMC·Cu Post·Silica·Alumina 등 복합소재를 단일 공정으로 가공할 수 있는 고정밀 Grinder 기술 개발이 진행되고 있으며, 국내 주요 반도체 제조사의 평가 프로젝트가 병행되고 있다. 제어계측기기 부문에서도 반도체 세정공정용 약액 제어 정밀도를 강화한 LFC 제품군의 업그레이드가 이루어지고 있다. 이러한 신규 라인업 확대는 2026년 이후 본격적인 수주 증가로 이어질 전망이다.

■ AI·친환경 기술 기반의 미래 로드맵 가동

동사는 중장기 성장 동력으로 실시간 공정 모니터링, 저전력·친환경 약액 제어 기술을 포함한 차세대 기술개발 로드맵을 추진하고 있다. 특히 제어 소프트웨어와 하드웨어의 통합 플랫폼을 개발해 장비 간 인터페이스 표준화를 목표로 하고 있으며, 연구개발비를 매출의 10% 이상 수준으로 유지해 기술 내재화를 가속화하고 있다. 또한 CE, ISO 9001, Inno-Biz 인증과 품질경영시스템 강화로 글로벌 시장 대응 역량을 높이고 있다.

[그림 8] 동사의 제품 제조 공정검사 및 공정실험 수행 현황



자료: 동사 홈페이지, 서울평가정보(주) 재구성

이엘씨(041520)

증권사 투자의견 예시(하단)

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
N/A	-	-	-

시장정보(주가 및 거래량)

한국거래소(KRX)



자료: 네이버증권(2025.11.17)

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다.

시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의7

기업명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
이엘씨	X	X	X